

## Pressemitteilung

Hanau, 22.11.2017

### **Heraeus Electronics und Mozaik Technology Ventures unterzeichnen globales Lizenzabkommen für fotostrukturierbare Dickfilmtechnologien**

#### **Mozaiks Technologie ermöglicht Heraeus die Entwicklung neuer Dickfilmpasten für ultrafeine Eigenschaften, die Leistung verbessern und Miniaturisierung vereinfachen sollen**

Heraeus Electronics, ein führender Anbieter von Materiallösungen für die Halbleiter- und Elektronikindustrie, hat eine Lizenzvereinbarung mit Mozaik Technology Ventures Limited, einem führenden Hersteller für superfeine Dickschichttechnologien, geschlossen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Heraeus Electronics zahlreiche fotostrukturierbare Dickschichttechnologien von Mozaik lizenzieren.

Die Partnerschaft mit Mozaik ermöglicht es Heraeus, das Lösungsangebot für Kunden zu erweitern, die elektronische Bauteile wie Sensoren, 5G-Hochfrequenz-Schaltkreise, kleinere passive elektronische Komponenten und Touchpanel-Displays herstellen. Der anhaltende Trend zu kleineren Elektronikbauteilen macht die Nutzung fortschrittlicher Materialien und Prozesstechnologien immer wichtiger. Die Technologie von Mozaik wird genutzt, um eine Plattform für Dickfilmpasten wie Silber-, Silber-Platin-, Silber-Palladium-, Gold- und Platin-Leitern und Keramik/Glas-Isolatoren für diese spezifischen Anwendungen zu schaffen.

„Wir haben bei Dickfilmmaterialien eine Entwicklung hin zu feineren Eigenschaften wie Leiter für feinste Linien festgestellt“, sagt Dr. Frank Stietz, President Heraeus Electronics. „Die Industrie muss die Nachfrage und die Anforderung hinsichtlich Miniaturisierung elektronischer Komponenten und mikroelektronischer Schaltkreise mit höherer Dichte erfüllen. Mit Mozaiks Produktlinien und Technologien werden wir neue Maßstäbe in der Leistungsfähigkeit setzen.“

Mit fotostrukturierbaren Dickfilmpasten von Heraeus Electronics können elektronische Komponenten und Schaltkreise mit Linien und Abständen unter 50 Mikrometern hergestellt werden. Aktuell sind mit herkömmlichen Dickfilmpasten 75 Mikrometer möglich. Derzeit werden aber die meisten Geräte in industriellem Maßstab mit 100 bis 150 Mikron gebaut.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Heraeus Electronics, einem starken und zuverlässigen Lieferanten von Materialien für die Elektronikindustrie. Mit unseren Pasten wird Heraeus weitere Innovationen in der Industrie fördern“, sagt Steve Muckett, Gründer und Managing

Director von Mozaik Technology Ventures. „Wir gehen davon aus, dass nun viele Hersteller von Komponenten auf Keramikbasis kostengünstige Lösungen einführen werden, die der Markt braucht.“

---

Der Technologiekonzern Heraeus mit Sitz in Hanau ist ein 1851 gegründetes und heute weltweit führendes Familienunternehmen. Mit fachlicher Kompetenz, Innovationsorientierung, operativer Exzellenz und unternehmerischer Führung streben wir danach, unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kontinuierlich zu verbessern.

Wir schaffen hochwertige Lösungen für unsere Kunden und stärken nachhaltig ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem wir Material-Kompetenz mit Technologie-Know-how verbinden. Unsere Ideen richten sich auf Themen wie Umwelt, Energie, Gesundheit, Mobilität und Industrielle Anwendungen. Unser Portfolio reicht von Komponenten bis zu abgestimmten Materialsystemen. Sie finden Verwendung in vielfältigen Industrien, darunter Stahl, Elektronik, Chemie, Automotive und Telekommunikation.

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Heraeus einen Umsatz ohne Edelmetalle von 2,0 Mrd. € und einen Gesamtumsatz von 21,5 Mrd. €. Mit weltweit rund 12.400 Mitarbeitern in mehr als 100 Standorten in 40 Ländern hat das in den FORTUNE Global 500 gelistete Unternehmen eine führende Position auf seinen globalen Absatzmärkten. Heraeus ist 2016 von der Stiftung Familienunternehmen als eines der „Top 10 Familienunternehmen“ in Deutschland ausgezeichnet worden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Morvyn Lipinski  
Manager Media Relations  
Communications & Marketing  
Heraeus Holding GmbH  
Telefon +49 61 81 35-97 93  
E-Mail [morvyn.lipinski@heraeus.com](mailto:morvyn.lipinski@heraeus.com)